

طراحی و ساخت میکروآئینه شکل‌پذیر پلیمری جهت استفاده در سیستم‌های اپتیک تطبیقی

مهرناز اسفندیاری^۱ رضا اسدی^۲ پیام حیدری^۳

۱- دانش آموخته کارشناسی ارشد، مجتمع مهندسی برق الکترونیک، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران
me_esfandiari2000@yahoo.com

۲- استادیار، مجتمع مهندسی برق الکترونیک، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران
rasadi56@gmail.com

۳- استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران
pheydari@riau.ac.ir

چکیده: در این مقاله روشی نوین جهت ساخت میکروآئینه انعطاف‌پذیر پلیمری مبتنی بر عملگر الکترواستاتیک ارائه شده است. میکروآئینه‌های انعطاف‌پذیر معمولاً در سیستم‌های اپتیک تطبیقی جهت تصحیح اعوجاج‌های موجود در جبهه موج نور بکار می‌روند. از این رو می‌بایست دارای دیافراگمی منعطف باشند. در این تحقیق دیافراگم میکروآئینه، از جنس پلیمر SU-8 ساخته شده و بر روی آرایه‌ای از الکترودهای ثابت قرار گرفته است. این دیافراگم با مدول یانگی حدود ۵۰ برابر کمتر از نمونه‌های رایج سیلیکونی، امکان جابجایی دیافراگم بیشتر و در نتیجه قابلیت تصحیح ابیراها با ولتاژ کمتر را مقدور می‌سازند به گونه‌ای که دیافراگم به شعاع ۲/۵mm و ضخامت ۱۰μm را با اعمال ولتاژ ۱۲۰ولت حدود ۴μm جابجا می‌کند. علاوه بر این، استفاده از مواد پلیمری بجای سیلیکون در ساخت دیافراگم، سادگی و کم‌هزینه بودن فرآیند ساخت را نیز به همراه دارد. اما دیافراگم‌های پلیمری رایج، صافی سطح کمتری در مقایسه با نمونه‌های سیلیکون دارند. در این مقاله برای غلبه بر این مشکل از راهکاری جدیدی برای ساخت میکروآئینه استفاده شده که علاوه بر تمام مزایای آئینه پلیمری از نظر صافی سطح با نمونه‌های سیلیکونی برابری می‌کند. نتیجه اندازه‌گیری ناهمواری سطحی حدود واریانس ناهمواری سطح ۲۰ نانومتر را نشان داد. همچنین، به منظور بهینه‌کردن طرح ساختاری از شبیه‌سازی المان محدود استفاده شده است.

کلمات کلیدی: اپتیک تطبیقی، پلیمر SU-8، عملگر الکترواستاتیکی، میکرو آئینه.

تاریخ ارسال مقاله: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

تاریخ پذیرش مشروط مقاله: ۱۳۹۵/۰۵/۱۸

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۰۹/۰۳

نام نویسنده‌ی مسئول: مهرناز اسفندیاری

نشانی نویسنده‌ی مسئول: مجتمع مهندسی برق الکترونیک، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

۱- مقدمه

در سیستم‌های اپتیکی، عواملی چون تغییر ضریب شکست محیط انتشار نور و وجود ذرات معلق در هوا موجب می‌گردد تا جبهه موج دچار اعوجاج و نوسان شود که در نهایت، مبهم شدن جزئیات تصویر را به همراه دارد. از بین بردن اثرات فوق نیازمند جبران‌سازی جبهه موج است که به‌وسیله سیستم‌های اپتیک تطبیقی^۱ انجام می‌پذیرد [۱].

سیستم‌های اپتیک تطبیقی شامل بخش‌های متعددی هستند که مهمترین آنها، آینه‌ها می‌باشند. با استفاده از این آینه‌ها، امکان رفع اثرات نامطلوب ناشی از ابیراهی‌های مختلف در سیستم‌های تصویربردار و افزایش دقت هندسی سیستم‌های اپتیکی فراهم می‌شود [۲ و ۳].

در یک سیستم اپتیک تطبیقی، دیافراگم آینه به صورت دینامیکی بگونه‌ای کنترل می‌شود که جابجایی فازی دقیقاً برخلاف جابجایی فازی که سبب ایجاد ابیراهی در جبهه موج مرجع شده را، به جبهه موج تابشی^۲ اعمال کند. در نتیجه این عمل، جابجایی فازی آینه آینه و ابیراهی، یکدیگر را خنثی کرده و جبهه موج نهایی کاملاً یکنواخت و عاری از هرگونه اعوجاج خواهد شد [۳].

کاربردهای اپتیک تطبیقی در سیستم‌های تصویر بردار در نجوم و صنایع نظامی و همینطور در زمینه‌های ارتباطات لیزر (سوچینگ و کوپلینگ) و تصویربرداری پزشکی (به ویژه چشم پزشکی^۳) مورد استفاده قرار می‌گیرد [۴].

در چشم پزشکی برای عکس برداری از شبکیه نیاز به ادوات اپتیک تطبیقی است؛ اما این قطعات با انواع مشابه که در تلسکوپ‌ها به کار می‌روند تفاوت‌هایی دارند. قطعاتی که در چشم پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرند باید کوچک، قابل حمل و ارزان قیمت باشند. این در حالی است که آینه‌های تطبیقی متداول، معمولاً مشکلاتی از قبیل هزینه بالا و وزن زیاد، پیچیدگی و ابعاد بزرگ را به همراه دارند اما در دهه‌های اخیر با بهره‌گیری از تکنولوژی MEMS^۴ و روش‌های میکروماشینکاری حجمی و سطحی، آینه‌های انعطاف پذیر در ابعاد میکرومتر تا توان مصرفی پایین، دقت و سرعت عملکرد بالا ساخته می‌شوند که برای بسیاری از کاربردهای اپتیک تطبیقی مناسب هستند [۵].

میکروآینه‌ها در دو نوع دیافراگم پیوسته و گسسته ساخته می‌شوند، که با توجه به خصوصیات منحصر به فردشان کاربردها متفاوتی دارند. اگرچه آینه‌های پیوسته سرعت کمتری نسبت به آینه‌های گسسته دارند و میزان جابجایی که ایجاد می‌کنند محدود است اما به سبب قابلیت بالای آنها در اصلاح جبهه موج و عدم ایجاد گسستگی فاز در جبهه موج تابیده شده و ضریب پرتشدگی^۵ مطلوب و ساخت ساده تر نسبت به آینه‌های گسسته، برای استفاده در سیستم‌های اپتیک تطبیقی بسیار مناسب تر هستند [۶].

مشخصات آینه‌های انعطاف پذیر بسته به کاربرد آنها متفاوت است اما بازرترین آنها عبارتند از: میزان جابجایی، سرعت پاسخ دهی و

صافی سطح [۷] که ارتباط مستقیم با نوع عملگری دارد که برای تحریک آینه به کار می‌رود. میکروعملگرهای الکترواستاتیکی، با توجه به مزایایی همچون حساسیت مناسب، پاسخ‌دهی سریع، دقت بالا، قابلیت مجتمع سازی با تکنولوژی CMOS و ساخت ساده‌تر نسبت به سایر عملگرها، همواره مورد توجه طراحان و سازندگان ادوات MEMS به‌ویژه در میکروآینه‌ها بوده‌اند. یکی از پرکاربردترین و متداول ترین این عملگرها، عملگر الکترواستاتیکی با دو صفحه موازی^۶ می‌باشد که علاوه بر فرآیند ساخت ساده‌تر، قابلیت پیاده‌سازی با مواد پلیمری را نیز دارد. از آنجائیکه پیچیدگی و زمان بر بودن مراحل ساخت و هزینه بالای تجهیزات همواره از مهمترین چالش‌های پیش رو در عرصه تولید قطعات MEMS بوده اند [۸]، لذا یافتن راهکارهایی برای ایجاد سهولت در ساخت و عدم نیاز به استفاده از روش‌های پرهزینه به‌ویژه برای تولید انبوه می‌تواند بسیار مثر و واقع شود.

اما نیروهای الکترواستاتیکی در ابعاد میکرومتر نسبتاً کوچک بوده و برای ایجاد جابجایی قابل توجه، ولتاژ تحریک بالایی نیاز دارند. حال آنکه استفاده از سیلیکون به عنوان پرکاربردترین ماده برای ساخت این قطعات، بر این مشکل می‌افزاید [۹ و ۱۰]. چراکه سیلیکون با داشتن مدول یانگ در حدود ۱۶۰ GPa نه تنها مقاومت مکانیکی بالایی در مقابل تغییر وضعیت مکانیکی از خود نشان می‌دهد، بلکه برای ایجاد جابجایی به نیروی الکترواستاتیکی زیادی نیاز دارد و این امر سبب افزایش ولتاژ تحریک مورد نیاز در عملگر الکترواستاتیکی می‌شود [۱۰]. برای رفع این مشکل، یکی از روش‌های پیشنهادی، استفاده از مواد پلیمری مانند SU-8 است که مدول یانگ آنها نسبت به سیلیکون کمتر است [۱۱]، اما با توجه به اینکه در این روش برای لایه نشانی SU-8 باید از لایه نشانی با صفحه چرخان^۷ استفاده کرد، و همچنین بدلیل تنش پسماند ایجاد شده در حین فرآیند تولید، دستیابی به سطوح صاف و بدون اعوجاج یکی از چالش‌های اصلی می‌باشد.

در این مقاله روشی نوین برای ساخت میکروآینه انعطاف پذیر پلیمری جهت استفاده در سیستم‌های اپتیک تطبیقی ارائه شده است. در این روش از دیافراگم پیوسته SU-8 با پوشش فلزی و قاب سیلیکونی بر روی مجموعه‌ای از عملگرهای الکترواستاتیک استفاده شده است. مزیت این روش صافی سطح مناسب به همراه سادگی نسبی فرآیند ساخت به علت استفاده از روش سونش شیمیایی می‌باشد. ضمن اینکه به علت استفاده از دیافراگم پلیمری با مدول یانگی ۵۰ برابر کمتر از سیلیکون [۱۱]، مقدار جابجایی قابل توجهی با ولتاژ تحریک نسبتاً پایین بدست می‌آید.

در روش ارائه شده، ضمن دستیابی به صافی مطلوب، با استفاده از سونش شیمیایی به جای سونش‌های متداول فیزیکی، نیاز به استفاده از تجهیزات گران‌قیمت و پیچیده مانند سونش خشک^۸ مرتفع گردیده و زمان ساخت در قیاس با سایر روش‌ها کاهش چشمگیری داشته‌است که آن را به گزینه مناسبی برای تولید انبوه به‌ویژه در ادواتی که دارای دیافراگم هستند مبدل می‌سازد.

$$D = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)} \quad (2)$$

که در رابطه (۱) نشان دهنده جابه‌جایی و D صلبیت خمشی ν و p میزان بار یا فشاری که روی صفحه اعمال می‌شود. همانطور که مشخص است مقدار D متأثر از نوع ماده، مدول یانگ E ، ضریب پواسون ν و ضخامت h آن می‌باشد [۱۴].

با حل رابطه (۱) و در نظر گرفتن شرایط مرزی $w(a)=0$ ، $w'(a)=0$ ، $w'(0)=0$ میزان جابه‌جایی نقطه به نقطه دیافراگم قابل محاسبه است. رابطه کلی جابه‌جایی دیافراگم دایره‌ای عبارت است از: [۱۴]

$$w(r) = \frac{pa^4}{64D} \left(1 - \frac{r^2}{a^2}\right) = w(0) \left(1 - \frac{r^2}{a^2}\right)^2 \quad (3)$$

در رابطه (۳)، شعاع دیافراگم، r شعاع پایه‌ای که دیافراگم بر روی آن قرار دارد و D ضریب صلبیت خمشی می‌باشد. با در نظر گرفتن رابطه بین نیرو و فشار می‌توان فشار اعمالی را با بر حسب نیروی الکتروستاتیکی بدست آورد.

$$p = \frac{f_e}{A} \quad (4)$$

$$f_e = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r V^2}{2g^2} \quad (5)$$

در رابطه (۵)، A مساحت الکترودها، ϵ ضریب دی الکتریک، ϵ_0 ضریب نفوذ پذیری خلاء، g فاصله بین صفحات و V ولتاژ اعمالی به الکترودها می‌باشد.

با جایگذاری روابط (۴) و (۵) در رابطه حاکم بر جابجایی دیافراگم میزان جابجایی دیافراگم دایره‌ای به صورت رابطه (۶) خواهد بود [۱۴].

$$w(r) = \frac{3(1-\nu^2)a^4 \epsilon_0 \epsilon_r V^2}{8Eh^3 g^2} \left[1 - \left(\frac{r}{a}\right)^2\right]^2 \quad (6)$$

با توجه به رابطه (۶) جابه‌جایی با E که معرف مدول یانگ است، رابطه خطی دارد. اما از آنجایی که رابطه جابجایی با تغییر در ضخامت دیافراگم (h) و فاصله بین صفحات (g)، یک رابطه معکوس به ترتیب با توان سوم و توان دوم است، این پارامترها تأثیر به‌سزایی در عملکرد میکروآیینه و میزان جابجایی دارند. به عنوان مثال با کاهش ضخامت دیافراگم جابه‌جایی میکرو آیینه می‌تواند به صورت چشم‌گیری افزایش یابد اما کاهش ضخامت تأثیر منفی بر روی صافی و یکنواختی سطح دیافراگم خواهد داشت.

۴- شبیه‌سازی

در این مقاله هدف از شبیه‌سازی بررسی جابجایی دیافراگم میکروآیینه به ازای تغییرات در پارامترهای مختلف است. از آنجاییکه پایین بودن ولتاژ تحریک در ساخت میکروآیینه‌ها یک نکته اساسی است از این رو

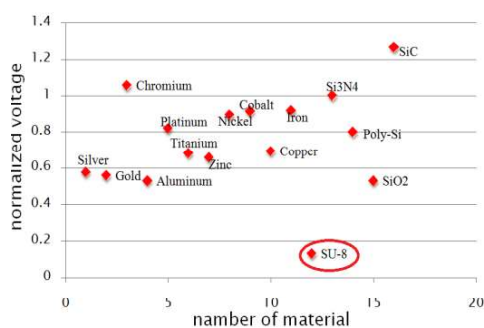
در شبیه‌سازی سعی شده تأثیر پارامترهای مختلف بر روی ولتاژ تحریک و میزان جابجایی بررسی شود.

با توجه به رابطه (۷) و (۸) که به ترتیب مشخص‌کننده ولتاژ تحریک و میزان جابجایی دیافراگم دایره‌ای می‌باشند، مشخص است که ولتاژ و جابجایی متأثر از دو بخش جداگانه است، یک بخش مربوط به مشخصات ساختار، مانند ابعاد و ضخامت دیافراگم است و بخش دوم مربوط به مشخصات ماده انتخاب شده به عنوان دیافراگم نظیر مدول یانگ می‌باشد.

$$V = \sqrt{\left(\frac{16\pi ER^3}{3t^2(1-\nu^2)} + 4\pi\sigma t\right) \times \frac{8g_0}{27A}} \cong \underbrace{\sqrt{\frac{E}{(1-\nu^2)}}}_{\text{خصوصیات}} \times \underbrace{\sqrt{\frac{Rg_0}{t^2}}}_{\text{هندسه ساختار}} \quad (7)$$

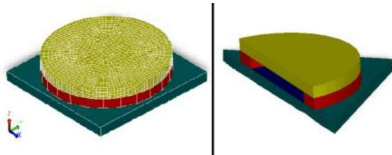
$$w(r) = \frac{3(1-\nu^2)a^4 \epsilon_0 \epsilon_r V^2}{8Eh^3 g_0^2} \left[1 - \left(\frac{r}{a}\right)^2\right]^2 \cong \underbrace{\frac{a^4}{h^3 g_0^2}}_{\text{هندسه ساختار}} \times \underbrace{\left[1 - \left(\frac{r}{a}\right)^2\right]^2}_{\text{خصوصیات مواد}} \quad (8)$$

از این رو انتخاب ماده مناسب جهت ساخت دیافراگم، نقش به‌سزایی در عملکرد قطعه دارد. معمولاً برای ساخت دیافراگم میکرو آیینه‌ها از موادی همچون سیلیکون نایتراید و یا SiO_2 استفاده می‌شود که دارای مدول یانگ بالایی هستند و نیروی زیادی نیز برای تحریک احتیاج دارند. اما در مقابل، مواد پلیمری مانند SU-8، می‌تواند جایگزین مناسبی برای این مواد باشد. با توجه به اینکه مدول یانگ SU-8 حدود $4/5 \text{ GPa}$ است [۱۱]، نسبت به موادی مانند Si یا Si_3N_4 که مدول یانگی حدود 160 GPa می‌باشد ولتاژ کمتری برای تحریک نیاز دارد [۱۵ و ۱۶].



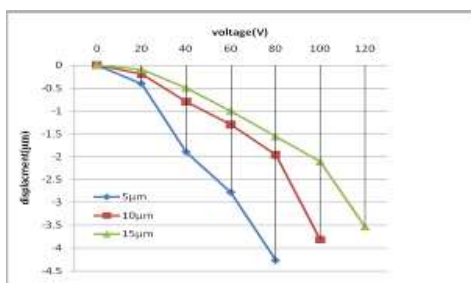
شکل (۳): ولتاژ تحریک نرمالیزه شده تعدادی از مواد نسبت به Si_3N_4

شکل (۳) ولتاژ تحریک مواد مختلف نظیر طلا، آلومینیوم، اکسید سیلیکون که نسبت به ولتاژ تحریک Si_3N_4 نرمالیزه شده است را نشان می‌دهد. علت اینکه ولتاژهای بقیه مواد نسبت به ماده Si_3N_4 نرمالیزه کرده‌ایم این است که این ماده یکی از متداولترین مواد در ساخت



شکل (۵): ساختار بدست آمده از شبیه‌سازی مراحل ساخت و مش‌بندی انجام شده توسط نرم‌افزار Coventor

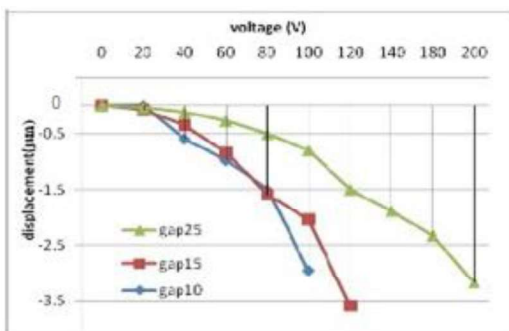
با توجه به اهمیت ضخامت دیافراگم و فاصله بین صفحات، این دو فاکتور توسط نرم‌افزار Coventor مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه بررسی میزان جابجایی مرکز دیافراگم به ازای سه ضخامت مختلف ۵، ۱۰ و ۱۵ میکرومتر که توسط نرم‌افزار Coventor انجام پذیرفته است، در شکل (۶) آمده است.



شکل (۶): نمودار میزان جابجایی به ازای اعمال ولتاژ برای ضخامت‌های مختلف دیافراگم با فاصله بین صفحات ۱۰ میکرومتر و شعاع ۲/۵ میلی‌متر

همانگونه که انتظار می‌رفت میزان جابجایی به ازای ضخامت کمتر دیافراگم، بیشتر خواهد بود لذا ضخامت ۱۰ میکرومتر به عنوان ضخامت مورد نظر جهت ساخت انتخاب گردید. ضخامت کمتر از این مقدار چالش‌های ساخت نظیر پارگی دیافراگم و عدم یکنواختی سطح را به همراه دارد [۱۸].

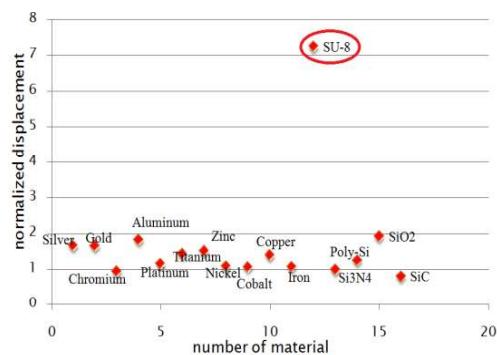
میزان جابجایی به ازای ولتاژ مختلف برای فاصله صفحات مختلف حاصل از شبیه‌سازی را می‌توان در شکل (۷) دید.



شکل (۷): نمودار میزان جابجایی به ازای اعمال ولتاژ در نمونه‌هایی با فاصله صفحات مختلف و ضخامت ۱۰ میکرومتر و شعاع ۲/۵ میلی‌متر

دیافراگم بوده و مدول یانگی نزدیک به سیلیکون دارد. همانگونه که این شکل نشان می‌دهد SU-8 ولتاژ تحریک کوچکتری نسبت به بقیه مواد دارد به عنوان مثال ولتاژ تحریک آن تقریباً سه برابر کمتر از ولتاژ تحریک اکسید سیلیکون و ۲ برابر کمتر از ولتاژ سیلیکون نایتراید می‌باشد. [۱۵ و ۱۶ و ۱۷]

پارامتر بعدی که در عملکرد میکروآئینه‌ها باید به آن توجه کرد میزان جابجایی است که به ازای ولتاژهای مختلف ایجاد می‌شود. هرچه این جابجایی بیشتر باشد عملکرد میکروآئینه چشم‌گیرتر است. هر چه مدول یانگ ماده کمتر باشد میزان جابجایی بیشتر خواهد بود. شکل (۴) میزان جابجایی دیافراگم دایره‌ای با مواد مختلف را نسبت به جابجایی دیافراگم از جنس Si_3N_4 نرمالیزه کرده ایم.



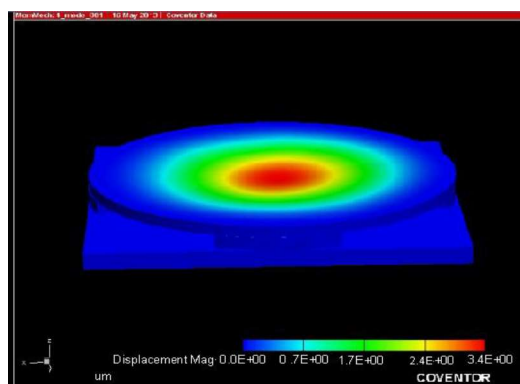
شکل (۴): جابجایی نرمالیزه شده تعدادی از مواد نسبت به Si_3N_4

با توجه به اینکه مدول یانگ SU-8 بسیار پایین بوده لذا همانگونه که انتظار داشتیم جابجایی دیافراگم ساخته شده با آن نسبت به بقیه مواد در ولتاژی یکسان به صورت چشمگیری بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال جابجایی ایجاد شده در دیافراگم SU-8 نسبت به جابه جایی دیافراگمی از جنس Si_3N_4 حدود ۷ برابر بیشتر بوده که این مقدار بسیار چشم‌گیر و حائز اهمیت است.

با مشخص شدن ماده مناسب جهت ساخت دیافراگم، نوبت به بررسی تاثیر عوامل ساختاری مانند ابعاد، ضخامت و فاصله بین صفحات بر روی میزان جابجایی و ولتاژ تحریک می‌رسد.

در این مقاله، برای تحلیل مکانیکی دیافراگم و بدست آوردن پاسخدهی سنسور مورد نظر به ولتاژ اعمال شده، از نرم افزار Coventor بهره گرفته شده است. این نرم‌افزار، علاوه بر حل مسائل دینامیکی در قطعات MEMS با تحلیل گره‌های مختلف، قابلیت شبیه‌سازی فرآیند ساخت و اطمینان از صحت فرآیند انتخابی قبل از اقدام به ساخت را نیز دارد که به نوبه خود ویژگی مهمی محسوب می‌گردد. چرا که شروع فرآیند ساخت در بسیاری از موارد هزینه‌بر بوده و امکان سنجی آن قبل از شروع فرآیند بسیار به‌صرفه می‌باشد. شکل (۵) ساختار ایجاد شده پس از شبیه‌سازی فرآیند ساخت و مش‌بندی انجام شده در Coventor را نشان می‌دهد.

شکل (۸) نیز شماتیکی از میزان جابجایی دیفراگم ۱۰ میکرومتر با فاصله صفحات ۱۰ میکرومتر به ازای اعمال ولتاژ ۶۰ ولت را نشان می-دهد.



شکل (۸): میزان جابجایی دیفراگم ۱۰ میکرومتر با فاصله صفحات ۱۰ میکرومتر و شعاع ۲/۵ میلی متر به ازای اعمال ولتاژ ۱۰۰ ولت

۵- روش ساخت

شکل ۹ خلاصه‌ای از فرآیند ساخت این میکروآیینه را نشان می‌دهد. جهت ساخت دیفراگم، ابتدا از نوع SU-8 2010 به روش لایه‌نشانی چرخشی با سرعت ۳۰۰۰ دور بر دقیقه به ضخامت ۱۰ میکرومتر روی یک بستر سیلیکونی لایه‌نشانی شده است. از سیلیکون به عنوان قاب نگه‌دارنده دیفراگم استفاده شده است. سپس ناحیه میانی سیلیکون را به شکل الگویی دایره شکل به طور کامل با روش سونش شیمیایی مرطوب با کاتالیزور فلزی [۱۹] سونش نموده‌ایم تا به SU-8 برسیم (شکل ۱۰-ب). در مرحله بعد، با استفاده از دستگاه لایه نشانی حرارتی، پشت دیفراگم با لایه‌ای از فلز طلا به ضخامت ۱۵۰ نانومتر پوشانده شده تا رسانا گشته و به عنوان الکتروود متحرک مورد استفاده قرار گیرد.

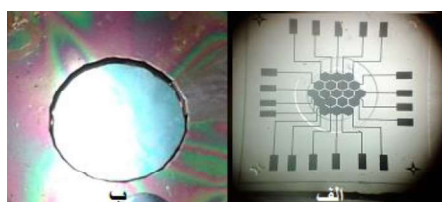


شکل (۹): مراحل ساخت

علاوه بر این، سونش سیلیکون با چنین عمقی (حدود ۴۵۰ میکرومتر) با بسیاری از روش‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد.

برای ساخت الکتروود و دیواره‌ها، ابتدا فلزات کروم و طلا به ترتیب با ضخامت‌های ۳۰ و ۱۲۰ نانومتر به روش لایه‌نشانی تبخیر حرارتی^{۱۴} روی زیرلایه‌های شیشه‌ای لایه نشانی شده و با استفاده از روش لیتوگرافی استاندارد، با ایجاد الگویی دایره‌ای شکل در ماده فتورزیست Shipley، سونش شده‌اند. سپس فتورزیست SU-8 2010 به ضخامت ۱۰ میکرون با استفاده از لایه‌نشانی چرخشی روی آن نشانداده شده و پس از پخت اولیه در دماهای ۶۵ و ۹۵ درجه با فرآیند لیتوگرافی استاندارد نوردهی گردید. در مرحله بعد، پخت بعد از نوردهی^{۱۵} در دماهای ۶۵ و ۹۵ درجه صورت گرفته و شکل دیواره‌ها در مایع ظهور^{۱۶} مختص به SU-8 ظاهر گردید (شکل ۱۰-الف).

در انتها، می‌بایست دیفراگم و دیواره‌ها به یکدیگر چسبانده شوند. راه‌های مختلفی برای چسباندن قطعات مختلف در سیستم‌های میکروالکترومکانیکی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به چسباندن با استفاده از ماده چسبیده^{۱۷} و چسباندن حرارتی اشاره نمود [۲۰]. در این مقاله به دلیل اجتناب از ایجاد تنش پسماند بین دیفراگم و سیلیکون که به علت تفاوت در ضریب انبساط حرارتی آنها رخ می‌دهد، روش چسباندن با استفاده از ماده چسبیده را انتخاب نمودیم تا از حرارت دادن مجدد دیفراگم جلوگیری بعمل آید. بدین منظور از لایه ای نازک از فتورزیست SU-8 2002 استفاده شده است. به این صورت که لایه ای از فتورزیست SU-8 2002 با استفاده از لایه‌نشانی چرخشی روی الکتروود زیرین لایه نشانی کرده (شکل ۱۰-الف) سپس دیفراگم پلیمری (شکل ۱۰-ب) را روی الکتروود زیرین قرار داده و با استفاده از میکروسکوپ نوری در محل مناسب قرار گرفته و با اندکی فشار در اطراف قاب سیلیکونی دو الکتروود به یکدیگر متصل شده و در نهایت با فرآیند لیتوگرافی استاندارد نوردهی گردید تا اتصال کاملاً محکم شود. به علت یکپارچه بودن ساختار امکان گرفتن تصویر میکروسکوپ الکترونی امکان‌پذیر نبود.



شکل (۱۰): الف) تصویری از الکتروود ها به همراه دیواره ب) دیفراگم پلیمری

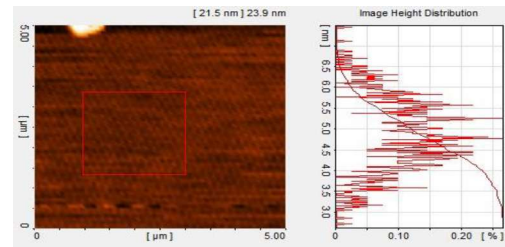
۶- بحث و نتایج

همانگونه که در قسمت مقدمه اشاره شد، سه پارامتر اصلی مشخص کننده کیفیت میکروآیینه عبارت‌اند از: صافی سطح، میزان جابجایی و سرعت پاسخدهی. برای بررسی این موارد در آیینه ساخته شده، پس از ساخت قطعه، ناهمواری‌های سطح آن با استفاده از میکروسکوپ اتمی^{۱۸}

مزیت عمده این روش این است که برای سونش سیلیکون نیازی به استفاده از دستگاه DIRE یا سایر روش‌های پرهزینه و زمان‌بر نیست.



اندازه‌گیری شد که حدود واریانس ناهمواری سطح ۲۰ نانومتر بدست آمد (شکل (۱۱)) آئینه می‌باشد؛

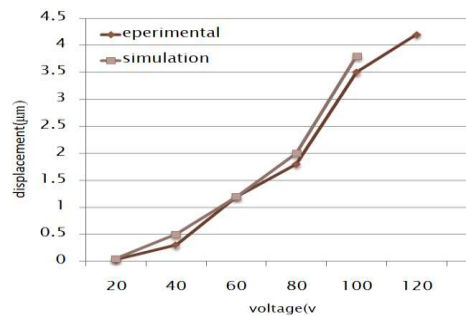


شکل (۱۱): ناهمواری سطح اندازه‌گیری شده توسط میکروسکوپ

نیروی اتمی

علاوه بر صافی سطح برای آمودن صحت عملکرد میکرو آئینه، ولتاژهایی در محدوده صفر تا ۱۲۰ ولت به همه الکترودها اعمال شده و جابجایی دیافراگم با استفاده از یک سیستم اپتیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سیستم اپتیکی مورد استفاده از نوع خودکانون بوده و نمودار جابجایی‌های اندازه‌گیری شده توسط این سیستم برای نمونه‌ی ساخته شده با فاصله صفحات و ضخامت دیافراگم ۱۰ میکرومتر به ازای ولتاژهای مختلف در شکل (۱۲) به نمایش در آمده است. همانگونه که در نمودار مشخص است، مقادیر بدست آمده از تست با مقادیر شبیه سازی تقریباً برابر است.

با توجه به شکل به ازای ولتاژ ۱۲۰ ولت میزان جابجایی ۴/۲ میکرومتر بوده که از $\frac{1}{3}$ فاصله بین صفحات بیشتر است این در حالی است که در عملگرهای الکترواستاتیکی با دو صفحه موازی، معمولاً در این فاصله پدیده قطع رخ می دهد اما در نمونه ساخته شده به سبب افزایش ثابت فنریت این پدیده در این فاصله رخ نداده و محدوده حرکت پایدار دیافراگم افزایش یافته است. همچنین همانگونه که نتایج نشان می‌دهد به سبب استفاده از دیافراگم پلیمری ولتاژ تحریک در محدوده مناسبی قرار دارد.



شکل (۱۲): نمودار میزان جابجایی به ازای اعمال ولتاژ برای دیافراگم به ضخامت ۱۰ میکرومتر

۷- نتیجه‌گیری

در پژوهش حاضر، روش جدیدی برای ساخت میکروآئینه انعطاف پذیر از جنس پلیمر جهت استفاده در سیستم های اپتیکی تطبیقی، پیشنهاد

و بر اساس آن یک نمونه میکرو آئینه با قابلیت جابجایی تا ۴/۵ میکرومتر طراحی و ساخته شد.

قطعه ساخته شده نسبت به نمونه های مشابه که معمولاً از جنس سیلیکون ساخته می شوند، قابلیت جابجایی بیشتر و ولتاژ کاری کمتری دارد. برای مقایسه در جدول (۱)، نتایج چند نمونه از قطعات ساخته شده مبتنی بر سیلیکون و نمونه ساخته شد در این تحقیق ارائه شده است.

جدول (۱): مقایسه ای بین میکرو آئینه های مشابه و میکرو آئینه ساخته شده

جنس	ابعاد	ضخامت	حداکثر ولتاژ	حداکثر جابجایی
[۲۱] سیلیکون نایتراید	۱*۱mm	۱ μm	۱۳۰	۲ μm
[۲۲] سیلیکون	۱ mm	۱ μm	۱۲۰	۲ μm
پلیمر SU-8	۲/۵ mm	۱۰ μm	۱۲۰	۴ μm

ضمن اینکه روش مورد استفاده در این تحقیق برای مواد پلیمری نسبت به روشهای دیگر بسیار ساده تر و کم هزینه تر می باشد. لذا می-توان از این روش به منظور تولید انبوه میکروآئینه برای کاربردهای متنوعی نظیر اپتیکی تطبیقی استفاده کرد.

مراجع

- [1] Kim, W., Kim, J., "Micro mirror array, manufacturing method of the micro mirror array, and floating display device including the micro mirror array". United States patent application US 15/205,754. 2017.
- [2] Bai, Y., "Design, Fabrication, and Characterization of a 2-D SOI MEMS Micromirror with Sidewall Electrodes for Confocal MACROscope Imaging". PhD thesis, Ontario: University of Waterloo, 2010.
- [3] Jia, K., "Development and application of high fill factor, small footprint MEMS micromirrors and micromirrors arrays". PhD thesis, university of Florida, 2009.
- [4] Kanno, I., Kunisawa, T., Suzuki, T., Kotera, H., "Development of Deformable Mirror Composed of Piezoelectric Thin Films for Adaptive Optics". IEEE journal of selected topics in quantum electronics. vol.13,pp. 155-161,2007.
- [5] Friese, Ch., Zappe, H., "Deformable Adaptive Optical Mirrors". Microelectromechanical system, vol.17, pp.11-19, 2008.
- [6] Zhu, G., Lévine, J., Praly, L., Peter, Y., "Flatness-Based Control of Electrostatically Actuated MEMS With Application to Adaptive Optics: A Simulation Study". Journal of microelectromechanical system, vol.15,2006.
- [7] Suzuki, J., Onishi, Y., Terao, K., Takao, H., Shimokawa, F., Oohira, F., Suzuki, T., "Development of a two-dimensional scanning micro-mirror utilizing magnetic polymer composite". Japanese Journal of Applied Physics, vol. 55, pp. 6S1-06GP01, 2016.
- [8] Metwally, K., Robert, L., "SU-8-based rapid tooling for thermal embossing". vol.15,pp.273-283,2011.

-
- ¹⁶ Developer
¹⁷ Adhesion Bonding
¹⁸ AFM

- [9] Tyng-Yow, Ch., , Chen, W.E., "A Large-Stroke MEMS Deformable Mirror Fabricated by Low-Stress Fluoropolymer Membrane". IEEE photonics technology letters ,vol.20,pp.830-832, 2008.
- [10] Towghian, Sh., "A Large-Stroke Electrostatic Micro-Actuator". PHD thesis ,University of Waterloo , Ontario, Canada, 2010 .
- [11] www.microchem.com, Jan. 2013.02.12.
- [12] Piyabongkam, D., Sun, Y., Rajamani, R., Sezen, A., "Travel Range Extension of a MEMS Electrostatic Microactuator".vol.13, pp.138-145,2005.
- [13] Edwards, J.M., "Modeling and feedback control of a MEMS electrostatic actuator", PhD thesis ,Cleveland State University, 2008 .
- [14] Bao M., "Analysis and Design Principles of MEMS Devices" Elsevier B.V,2005.
- [15] Hu, F., Tang, Y., Qian, Y., "Design of a MEMS micromirror actuated by electrostatic repulsive force" Optik, vol.123,pp.387-390, 2012.
- [16] Sasaki, T., Hane, K., "Initial deflection of silicon-on-insulator thin membrane micro-mirror and fabrication of varifocal mirror", Sensors and Actuators A: Physical ,vol.172, pp.516-522, 2011.
- [17] Hu, F., Yao, J., Qiu, Ch., Ren, H., "A MEMS micromirror driven by electrostatic force" Journal of Electrostatics, vol.68,pp.237-242, 2010.
- [18] Friese, Ch., Wissmann, M.," Polymer-based membrane mirrors for micro-optical sensors" IEEE, pp.667-672, 2003.
- [19] Lianto, P., Yu, Sh., Wu, J., Thompsonad, V., "Vertical etching with isolated catalysts in metal-assisted chemicaletching of silicon". The Royal Society of Chemistry, pp . 1-8, 2012.
- [20] Shamsi, A., Amiri, A., et el, "low cost method for hot embossing of microstructures on PMMA by SU-8 master".microsystem technology, vol.20, pp. 1925-31, 2014.
- [21] Gupta, A., kumar, S., " Deformable Membrane Mirror for Wavefront Correction". Defence science journal, vol.59, pp.590, 2009.
- [22] Kurczynski, P., Dyson, H., "Fabrication and measurement of low-stress membrane mirrors for adaptive optics".applied optics, vol.43, pp. 3573-80, 2004.

زیر نویس ها

-
- ¹ Adaptive optic system
 - ² incident wavefront
 - ³ ophthalmology
 - ⁴ Microelectromechanical
 - ⁵ Fill factor
 - ⁶ Parallel plate
 - ⁷ Spin coating
 - ⁸ DRIE
 - ⁹ Bonding
 - ¹⁰ Pull in
 - ¹¹ Kirchhoffs plate theory
 - ¹² flexural rigidity
 - ¹³ silicon-on-insulator
 - ¹⁴ Thermal evaporation deposition
 - ¹⁵ Post Bake

